

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2023/135401 A1

(43) Date de la publication internationale
20 juillet 2023 (20.07.2023)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :

H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/78 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2023/050061

(22) Date de dépôt international :

17 janvier 2023 (17.01.2023)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

FR2200361 17 janvier 2022 (17.01.2022) FR

(71) Déposant : SOITEC [FR/FR] ; Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN (FR).

(72) Inventeur : GHYSELEN, Bruno ; c/o SOITEC, Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques, 38190 BERNIN (FR).

(74) Mandataire : REGIMBEAU ; 20, rue de Chazelles, 75847 PARIS CEDEX 17 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) :

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) :

ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A STRUCTURE COMPRISING AT LEAST TWO TILES ON A SUBSTRATE

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE STRUCTURE COMPRENANT AU MOINS DEUX PAVES SUR UN SUBSTRAT

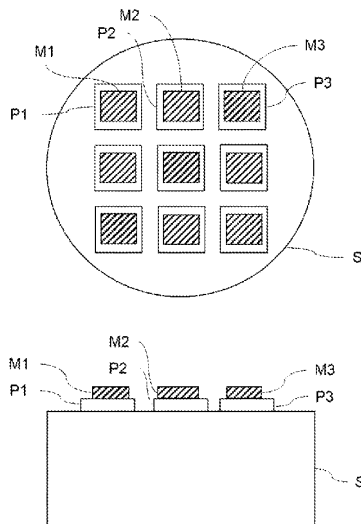


FIGURE 6

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a structure comprising at least two tiles on a substrate, said method comprising: - placing, on a support substrate (1, 3, S), at least two tiles ((P1, P2), (P'1, P'2)), said tiles being arranged on said support substrate (1, 3, S) in an incorrect distribution and/or geometry compared with a target distribution and/or geometry; - forming a mask comprising a protective film (M1, M2) that at least partially covers said tiles ((P1, P2), (P'1, P'2)) according to a pattern that defines the target distribution and/or geometry and at least one opening extending around the protective film (M1, M2); - etching at least one tile (P1, P2, P'1, P'2) through the opening in the mask so as to correct the arrangement of the tiles according to the target distribution and/or geometry.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une structure comprenant au moins deux pavés sur un substrat, comprenant : - le placement, sur un substrat support (1, 3, S), d'au moins deux pavés ((P1, P2), (P'1, P'2)) lesdits pavés étant agencés sur ledit substrat (1, 3, S) support selon une distribution et/ou une géométrie erronée par rapport à une distribution et/ou une géométrie cible; - la formation d'un masque comprenant un film protecteur (M1, M2) recouvrant en partie lesdits pavés ((P1, P2), (P'1, P'2)) selon un motif définissant la distribution et/ou la géométrie cible et au moins une ouverture s'étendant autour du film protecteur (M1, M2); - la gravure d'au moins un pavé (P1, P2, P'1, P'2) au travers de l'ouverture du masque de sorte à corriger l'agencement des pavés selon la distribution et/ou la géométrie cible.

[Suite sur la page suivante]

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17(iv))*

Publiée:

- *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*
- *avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues (règle 48.2(h))*